

Singulation System

Model LGR1040



Half-cut machine suitable for wettable QFN packages

ウェットブルQFNパッケージに適した ハーフカット装置

製品情報



日本語

- QFNパッケージのようなリードレスのデバイス製品の高精度なレーザーカットを実現
- プロセスやフレームデザインに合わせて、
ブレードカット (FMS3040-HC) またはレーザーカット (LGR1040) を選択可能
- 専用リードフレームとレーザーを組み合わせ、安定した溝深さ確保を実現



SPECIFICATION

Items		Unit	Description		
モデル		—	LGR1040		
ワークサイズ	長さ	mm	240—300		
	幅	mm	74—100		
	厚み	mm	0.6—2.0		
パッケージサイズ	最小	mm	1×1		
	最大	mm	40×40 (Scan FOV)		
基板反り量		—	4mm／300mm (Max.)		
レーザー		—	1 Head, Single table		
外形寸法	モジュール	module	Loader	Cut Engine	Unloader
	幅	mm	950	700	850
	奥行き	mm	900	1,700	900
	高さ	mm	1,700	1,700	1,700
重量		ton	1.5		
ワーク供給部	タイプ	—	スリットマガジン		
	数量	pcs	4 (Max.) マガジン幅115mmの場合		
製品収納部	タイプ	—	スリットマガジン		
	数量	pcs	4 (Max.) マガジン幅115mmの場合		
キット交換時間		min	20		
製品搬送方式		—	Vacuum		
製品処理能力		UPH	4,600 at QFN4×4 (672 packages／workpiece)		

・上記数値は当社標準機の場合です。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.
シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.
タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
ドイツ
TOWA Europe GmbH
オランダ
TOWA Europe B.V.
アメリカ
TOWA USA Corporation